

シャープ三重工場における半導体先端パネルパッケージ※1の 生産ライン構築について



シャープ三重事業所（三重県多気郡多気町）

アオイ電子株式会社（以下「アオイ電子」）とシャープ株式会社およびシャープディスプレイテクノロジー株式会社（以下、後者の2社を総称し「シャープ」）※2は、シャープの液晶パネル工場の建物や施設を活用したアオイ電子による半導体後工程※3の生産ライン構築を推進していくことに合意し、本日、基本合意書（以下「合意書」）を締結しました。

今回、生産ライン構築を予定しているのは、シャープ三重事業所の第1工場（延床面積 約6万平方メートル）です。アオイ電子は、2024年中に半導体先端パネルパッケージの生産ラインの構築に着工し、2026年中の本格稼働（パネル生産能力2万枚/月）を目指します。

アオイ電子では、既存工場を活用することで生産ラインの早期構築・稼働を図り、今後拡大が見込まれるチップレット集積パッケージ、チップ埋め込み型パワーパッケージ、5G/6G/ADAS※4用高周波パッケージをタイムリーに提供していく予定です。

シャープでは、中小型液晶パネル工場の生産能力の最適化に加え、未利用・低利用となっている工場の活用、さらには他社協業による事業展開を進めており、本件はその一環となります。

今後、本合意書の内容をもとに、生産ラインの早期構築と本格量産に向け、3社間で半導体後工程における連携を検討してまいります。

- ※1 先端パッケージニーズに対応した、アオイ電子のFOLP®(Fan-out Laminate Package)を生産予定です。
- ※2 アオイ電子株式会社 : 本社/香川県高松市、代表取締役社長/木下和洋
シャープ株式会社 : 本社/大阪府堺市、代表取締役社長執行役員 兼 CEO/沖津雅浩
シャープディスプレイテクノロジー株式会社: 本社/三重県亀山市、代表取締役社長/川合勝博
- ※3 半導体後工程は半導体チップを電子回路基板に実装できるようパッケージ化する工程です（ここでは、昨今半導体の性能向上に向けて期待が高まる、複数の半導体チップを組み合わせる中工程を含む）。一方、前工程とは半導体ウエハ上にトランジスタ等を形成し、半導体の集積チップを作る工程を言います。
- ※4 Advanced Driver-Assistance Systemsの略。ドライバーの運転操作支援する先進運転支援システム。